

Polish Grinder

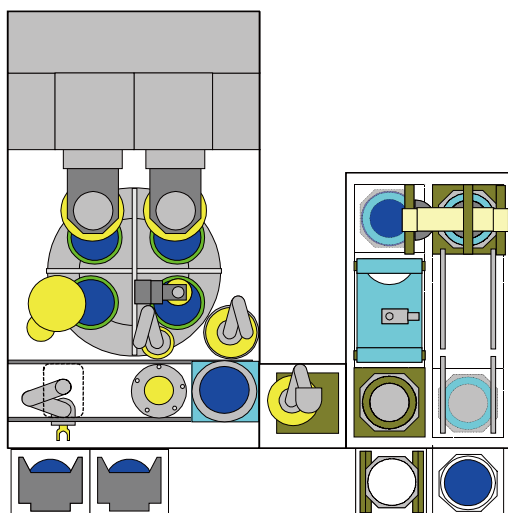
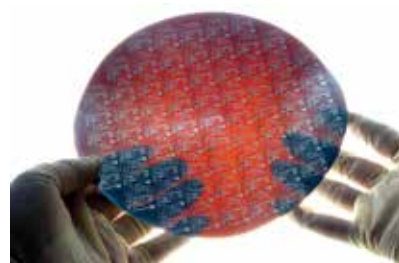
PG3000RMX



株式会社東京精密

Polish grinders

ウェーハ厚さ 15 ミクロンを高スループットで量産可能なシステム・インテグレーション、ポリッシュ・グラインダ PG3000RMX



薄片化

25 ミクロンのウェーハ厚さが加工できるアプリケーションと搬送できるシステムを備えて実現しました。

仕上げの多様化

ウェットポリッシュによるストレスリリーフのみならず、ゲッタリングに必要な EGF などのアプリケーションを提供できます。

拡張性

ステルス・ダイシングとのシステムインテグレーションなど、より高品質なアプリケーションを提供できます。

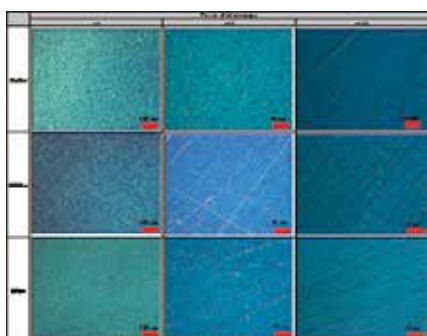
Various option



■ NCIG (Non Contact Inprocess Gauge) 自動 TTV 機能搭載

非接触タイプのウェーハ厚さゲージを搭載する事が可能です。

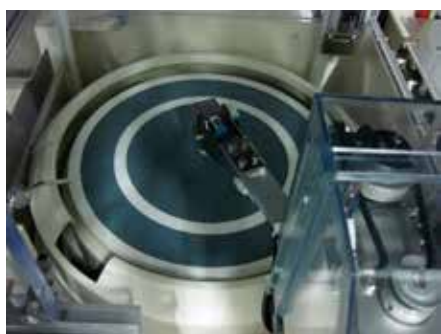
直接シリコンウェーハの厚さのみを計測してインプロセスで厚さ制御する事ができるので、表面保護テープの厚さバラツキや、WSS などの基盤及び接着層の厚さバラツキの影響を受けずに、仕上げ厚さの精度向上が達成できます。また、削った後のウェーハ形状を測定する自動 TTV 補正機能を搭載することで安定したウェーハを提供いたします。



■ EGF (Extrinsic Gettering Function)

ウェーハ裏面に金属イオンを捕捉する微小な欠陥を付与する事が可能です。

ウェーハの厚さが薄くなるとシリコンウェーハ内部にある IG 層 (Intrinsic Gettering) が除去されてしまう為、金属イオンを捕捉する欠陥層が不足します。チップの抗折強度を維持しながらウェーハ裏面に微小欠陥を付与する事で EG 層を形成する事ができます。



■ WCS (Wafer Cleaning System)

多様なウェーハ洗浄システムを提供できます。ウェーハ裏面のパーティクルの除去やコンタミネーションの除去は、デバイスやパッケージの観点から年々要求度合いが増しています。スクラビングブラシ洗浄、メガソニック洗浄、SC1 洗浄など多様なウェーハ洗浄を用いて要求に見合った結果を得る事ができます。



■ Mahoh Inline System (Integration System)

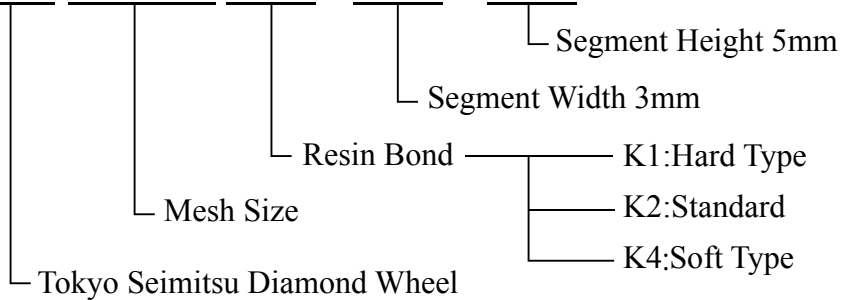
ステルス・ダイシング (SD レーザ) とのインテグレーションシステムを提供できます。特にウェーハが薄くなると、従来のブレードダイシングによる品質の維持が困難な傾向にありますが、当社独自の SD レーザを用いる事によりウェーハが薄くなっても高品質なダイシング品質が得られます。システムはインテグレーションされ、自動化され、薄いウェーハでも信頼性の高いハンドリングを可能にしています。

ACCRETECH CONSUMABLE

■ Grinding Wheel



T D 2 0 0 0 K 2 - 3 W - 5 X - 3 0 0



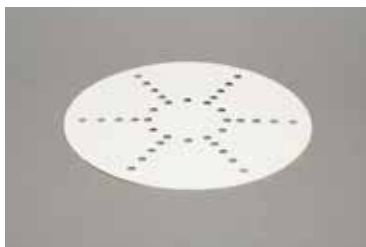
■ Dressing Disk

- *TB325
- *TB2000



■ Polishing Pad

- *TP200V4 (For PG200)
- *TP300V4 (For PG300/PG3000)



■ Polishing Slurry

- *TS200L (Standard)
- *TS200H (Low contamination)
- *TS200S (High throughput)

株式会社東京精密

お問合せはお近くの取扱店まで

<http://www.accretech.jp/>

■ 半導体製造機器取扱営業所

東京営業所	(042) 631-5211	(042) 631-5234
大阪営業所	(06) 6821-0361	(06) 6821-0210
九州営業所	(097) 538-1985	(097) 538-1989

■ 半導体製造機器サービスステーション

仙台出張所	(022) 224-0177	(022) 224-7083
山形出張所	(023) 631-5125	(023) 625-4129
鶴岡出張所	(0235) 29-8020	(0235) 29-8022
東京CE課	(042) 642-0358	(042) 642-0367
東京CE課/土浦出張所	(0298) 34-8550	(0298) 31-6808
四日市出張所	(0593) 61-6610	(0593) 66-2210
北陸出張所	(076) 422-6756	(076) 422-6757

大阪CE課	(06) 6821-0225	(06) 6821-0210
東広島出張所	(082) 493-5618	(082) 493-5619
熊本出張所	(096) 387-5188	(096) 386-1592
九州CE課	(097) 534-3291	(097) 538-1989
国分出張所	(0995) 43-2510	(0995) 43-2586
八王子パーツセンター	(042) 642-0381	(042) 642-0397

■ 東精エンジニアリング

土浦事業所CEグループ	(029) 830-1882	(029) 830-1881
土浦事業所パーツセンター	(029) 830-1882	(029) 830-1881
名古屋事業所	(0561) 32-3605	(0561) 34-2744